この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、
当社が予想を行ったものであり、潜在的リスクや不確実性を含んでいます。
最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

KYOCERA

事業戦略説明会2026

2031年3月期経営計画



2026年11月26日

代表取締役社長　兼　執行役員社長
最高経営責任者
作島　史朗

© 2026 KYOCERA Corporation

アジェンダ

1. はじめに
2. 2031.3期に向けた事業成長の考え方
3. 事業戦略
   - 部品事業
   - ソリューション事業
4. コーポレート
   - 事業ポートフォリオマネジメント
   - 研究開発投資
   - 資本政策
5. 最後に

© 2026 KYOCERA Corporation

京セラグループが大切にすること

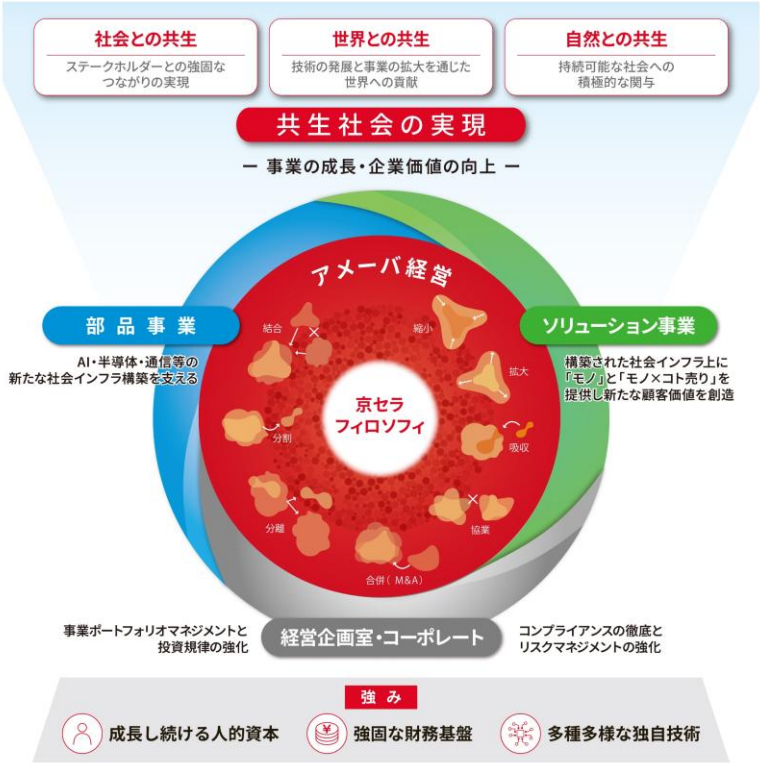
経営理念

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、
人類、社会の進歩発展に貢献すること

目指す姿

社会的価値向上と経済的価値向上を両立させ
全てのステークホルダーから信頼される
「ザ・カンパニー」へ

当社の価値創造ストーリー



© 2026 KYOCERA Corporation

京セラグループの独自性

2つの事業基盤で成長機会を継続的に創出

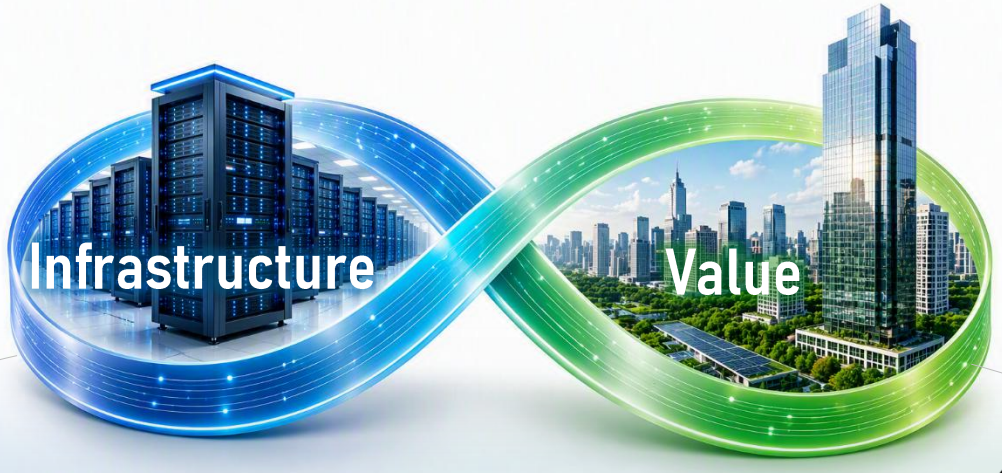
新しい技術

人類、社会の進歩発展

創る

（部品事業）

AI・半導体・通信等の新たな社会インフラ構築を支える



活かす

（ソリューション事業）

構築された社会インフラ上に「モノ」と「モノ×コト売り」を提供し新たな顧客価値を創造

光学　薄膜　ファインセラミック　電子・電気制御技術　通信・ソフト

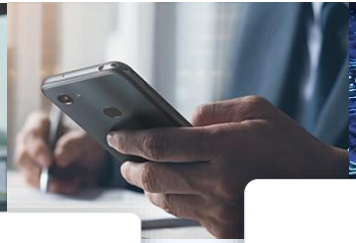
保有技術の多角的融合で社会に貢献

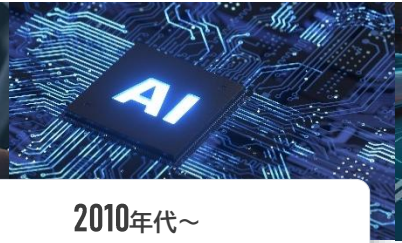
© 2026 KYOCERA Corporation

社会背景

人・AI・モノが共創する時代へ











1990年代～
つながる社会

インターネットとPC・携帯が普及し、
個人が組織から自立して選択する時代

PC
携帯電話
インターネット

2010年代～
つながる個の社会

スマホとクラウドで個がネットワーク化し、
協働と情報共有が加速する時代

スマホ
SNS
クラウドサービス

2030年代～
共創する社会

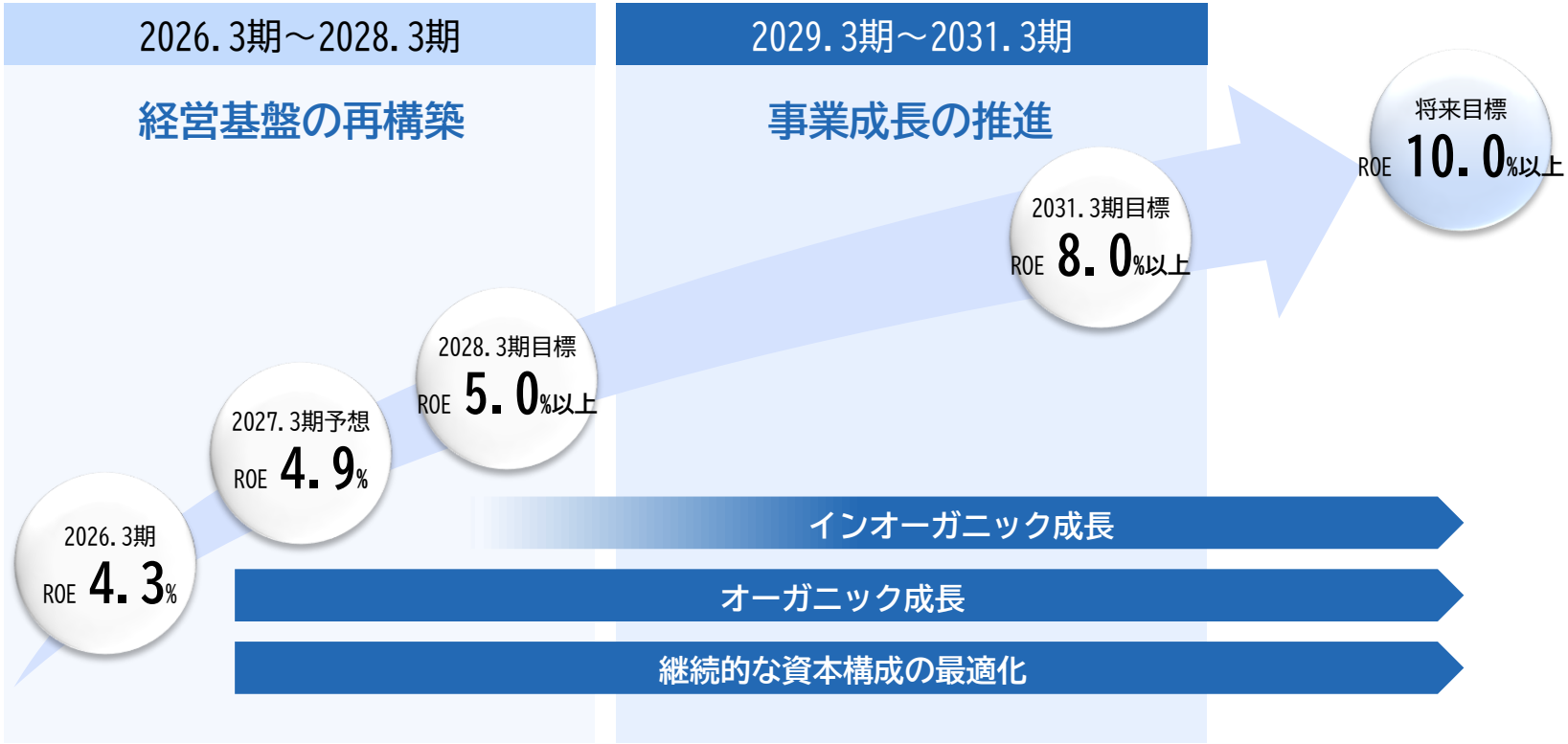
AIエージェントやロボットと人が協働し、
多主体で価値を共創する社会

フィジカルAI
AIエージェント
AIデータセンター
高性能半導体
自動運転（ADAS）

© 2026 KYOCERA Corporation

京セラの企業価値向上ロードマップ

（2026年2月公表ベース、2026.3期ROEは実績、2027.3期予想ROEは2026年11月時点）



© 2026 KYOCERA Corporation

2031.3期 経営計画

	2026.3期 実績	2027.3期 業績予想	2031.3期 計画
売上高	2兆　702億円	2兆1,200億円	2兆6,000億円
営業利益	1,181億円 (5.7%)	1,600億円 (7.5%)	3,200億円 (12.3%)
税引前利益	1,690億円 (8.2%)	2,000億円 (9.4%)	3,300億円 (12.7%)
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,410億円 (6.8%)	1,600億円 (7.5%)	2,500億円 (9.6%)
ROE	4.3%	4.9%	8.2%
設備投資額	1,491億円 (7.2%)	5年間合計	9,000億円
研究開発費	1,157億円 (5.6%)	5年間合計	6,500億円

© 2026 KYOCERA Corporation

2031.3期に向けた事業成長の考え方

部品事業（コアコンポーネント/電子部品）

AI周辺ネットワーク/半導体製造装置用部品、
次世代モビリティシステム関連製品の
成長牽引事業に積極的に投資し
売上・利益ともに成長

ソリューション事業

グローバル事業基盤を活用し、
「モノ」の進化と「モノ×コト売り」の
事業創出により収益力を強化

コーポレート

事業戦略と密接に連携した設備投資・研究開発投資を実行するため
事業ポートフォリオマネジメントの仕組み構築/運用により投資規律を強化

設備投資　研究開発投資　資本政策

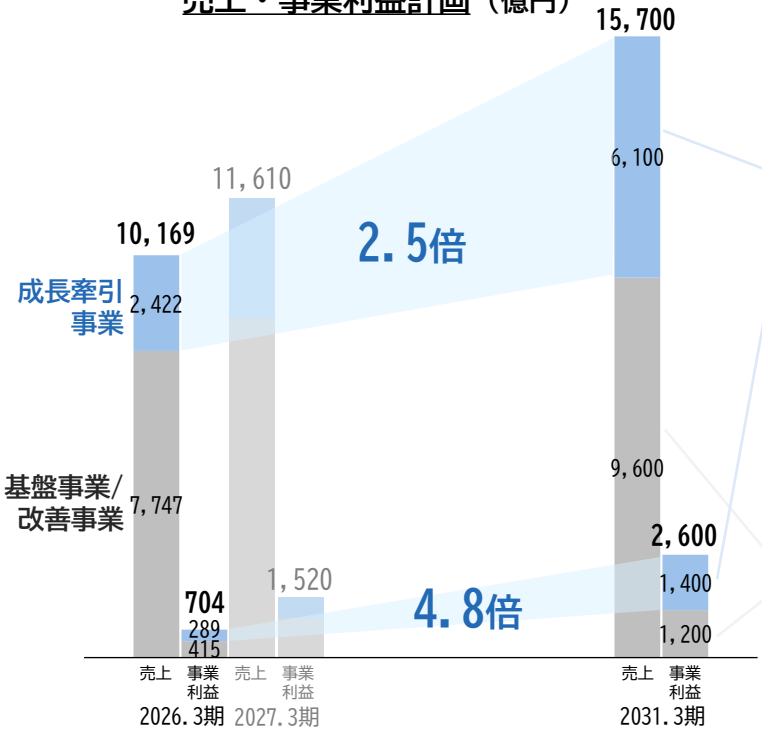
© 2026 KYOCERA Corporation

部品事業

© 2026 KYOCERA Corporation

部品事業　ー　2031.3期 事業計画

売上・事業利益計画（億円）



ROIC：4.5% → 12.5%

成長牽引事業

- AI周辺ネットワーク用部品
- 半導体製造装置用部品
- 次世代モビリティシステム関連製品

多様かつ強固な顧客基盤を軸に戦略的にリソースを集中

基盤事業/改善事業

アメーバ経営の強みである徹底した採算改善・創意工夫により売上・収益性を高める

- KAVX※：車載向け/航空宇宙向けMLCC等のさらなる生産性改善とシェア向上
- 有機基板事業：FCCSP/Moduleの縮小・撤退　など

※Kyocera AVX Components Corporation

© 2026 KYOCERA Corporation

成長牽引事業（製品カテゴリー）

（各製品カテゴリーの売上CAGRは26.3期～31.3期）

AI周辺ネットワーク用部品

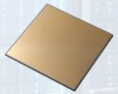
売上 CAGR 29%

AIデータセンター内外での幅広い部品群が強み

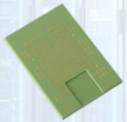
売上高（利益率）	2026.3期	2031.3期
	860億円（7.5%）	3,100億円（約27%）



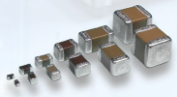
長距離伝送光通信用パッケージ



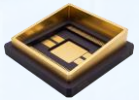
多層セラミックコア基板



データセンター間光通信用セラミック基板



MLCC



光スイッチ用セラミックパッケージ



ポリマータンタルコンデンサ

半導体製造装置用部品

売上 CAGR 14%

高シェアの構造部品に加え、静電チャックなどでシェア拡大

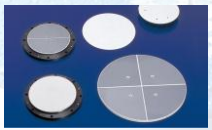
売上高（利益率）	2026.3期	2031.3期
	941億円（17.6%）	1,800億円（約20%）



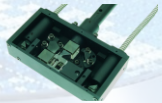
構造部品



ヒーター



静電チャック



アライメントレンズ



露光用レンズユニット

次世代モビリティシステム関連製品

売上 CAGR 14%

自動車部品技術・品質をベースに新たな事業の軸を構築

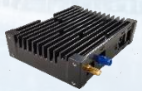
売上高（利益率）	2026.3期	2031.3期
	621億円（9.4%）	1,200億円（約15%）



車載カメラ



ITSモジュール/システム



ミリ波センサ基板

バイフォーカルミラー

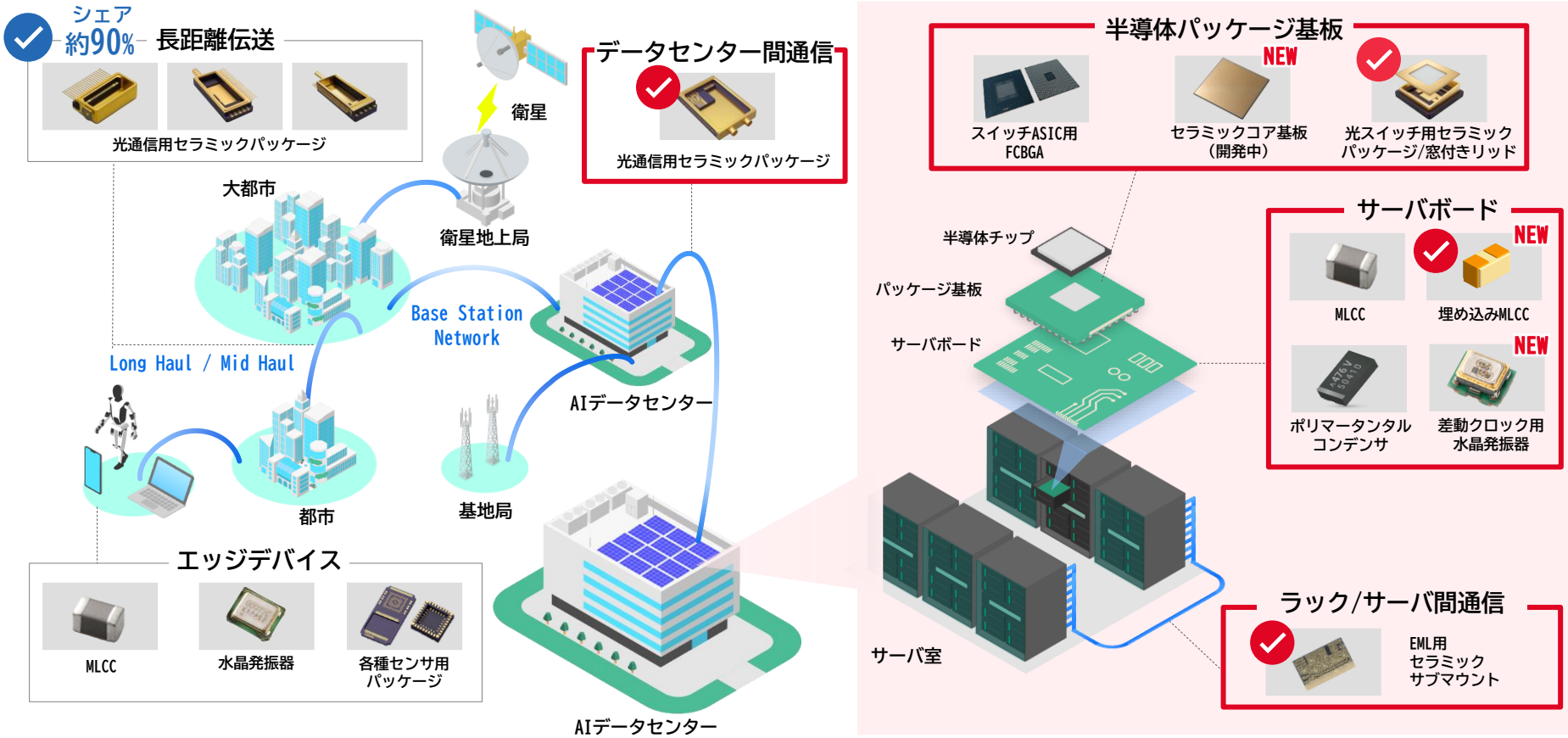


光表示デバイス

© 2026 KYOCERA Corporation

※シェアは当社推計値

AIデータセンター及び周辺ネットワークを支える京セラの製品群



© 2026 KYOCERA Corporation

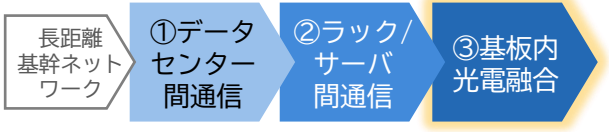
※シェアは当社推計値

AI周辺ネットワーク用部品 ー 光通信用セラミックパッケージ

市場トレンド

- AI光トランシーバー市場成長率：**19.1%**
  （26.3期～31.3期CAGR，当社推計値）
- AIクラスタ巨大化
  →GPU/サーバ間データ量急増
  →電気配線の速度・消費電力で限界

光通信の適用範囲拡大



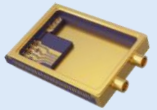
ターゲット顧客

① AIデータセンター間/幹線系
② AIデータセンター内ラック/サーバ間
③ 次世代領域：光電融合
の各領域における
光通信デバイスメーカー

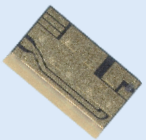
当社戦略

30年以上の供給実績と顧客との強固な信頼関係

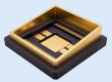
① データセンター間/幹線系
- セラミックパッケージ　現シェア90%以上
- 需要増に対する増産体制構築・高シェア維持

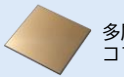

データセンター間
セラミックパッケージ

② ラック/サーバ間
- サブマウント　現シェア約30%
- AIサーバのスケールアップに対して、当社が持つ高周波設計技術等サーバ周辺の複数の製品技術を組み合わせて提案力を高めシェアを拡大


EML用セラミック
サブマウント

③ 次世代領域
- 光と半導体がさらに近接する領域へCPO（Co-Packaged Optics）や光スイッチ用新製品を展開


光スイッチ用
セラミック
パッケージ


多層セラミック
コア基板

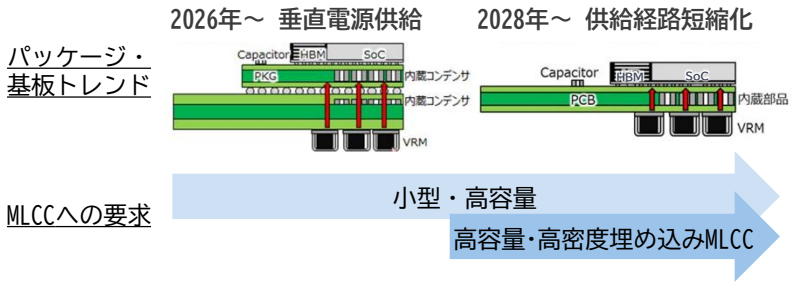
© 2026 KYOCERA Corporation

AI周辺ネットワーク用部品 ー 小型・高容量MLCC

市場トレンド

- AIサーバ向けMLCC市場成長率：**38.5%**
  （26.3期～31.3期CAGR，当社推計値）
- AIサーバの演算性能向上
  →消費電力の増加

GPU等に大電流を安定供給する重要性の高まり



情報処理量	現行の3倍	現行の10倍
消費電力	現行の1.5倍	現行の3.6倍
インピーダンス	1mΩ	0.01mΩ
コンデンサ員数	20,000 pcs	30,000 pcs～

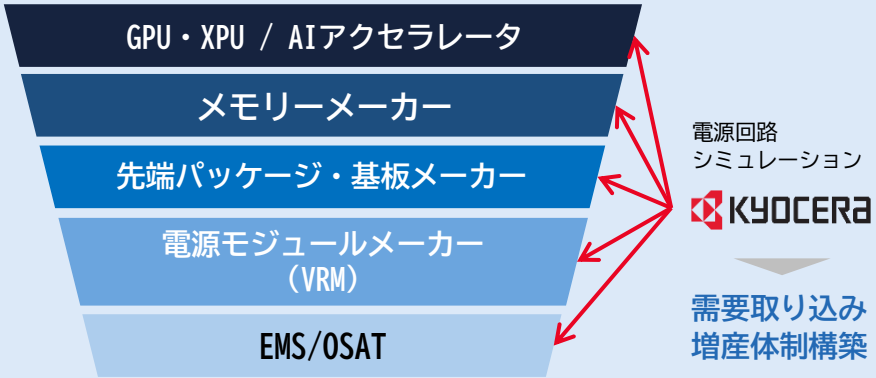
当社戦略

強みを活かした製品で低消費電力化を実現



- スマホ市場で20年以上にわたり培ってきた強み
  ✓ 小型・高容量技術、材料の微細化、薄層化/積層技術
- 各サイズで業界最高クラスの製品開発/量産力

AIデータセンター各階層の主要企業との連携



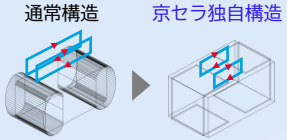
© 2026 KYOCERA Corporation

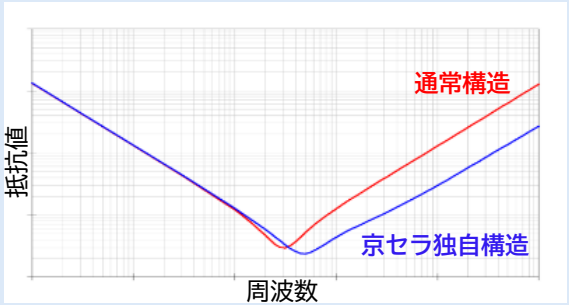
AI周辺ネットワーク用部品 ー 埋め込みMLCC

低インダクタンス・高い寸法精度のMLCC内蔵要求に対し独自技術で実現

特長① 低インダクタンス

通常より小さいインダクタンスループを
形成し、要求される低インダクタンスを実現





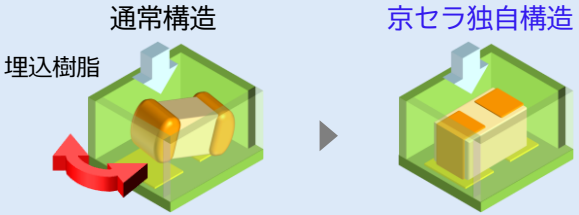


埋め込みMLCC

京セラ独自技術を用いた内蔵用MLCC

特長② 平坦な端子電極による高い寸法精度

平坦な端子電極面により実装位置が安定



基板メーカーから他社製品と比べて
歩留り面で高い評価

Why KYOCERA？

京セラグループが持つ技術の融合により低消費電力化に貢献

KAVXが持つ知的財産 × スマホ用で培った市場実績と顧客基盤 × 京セラの設計技術力（パッケージ・基板技術含）

© 2026 KYOCERA Corporation

※シェアは当社推計値

半導体製造(前工程)を支える京セラの製品群



© 2026 KYOCERA Corporation

半導体製造装置用部品 ー エッチング装置用次世代静電チャック

市場トレンド

- 半導体製造装置市場成長率：**14.7%**
  （26.3期～31.3期CAGR，当社推計値）
- 半導体の微細化・高積層化
  - **露光・現像やエッチング工程数増加**
  - **エッチング装置用部品に対する要求仕様が高度化**
    - ✓ プラズマの高出力化
    - ✓ ガス種の多様化
    - ✓ 温度条件の厳格化

ターゲット顧客・製品

AIチップなどに不可欠な半導体製造用の
専用機械やシステムを開発・提供する
半導体製造装置メーカー

当社戦略

長年のカスタム対応で培った市場実績と顧客基盤

×

独自の材料開発力と成形・加工技術力



次世代静電チャック

当社コア技術

1. 独自の高硬度アルミナ材料技術
2. 高精度シミュレーション技術/量産技術

社内リソースを集中・活用し
成長市場でのシェア向上を目指す

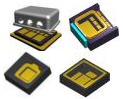
© 2026 KYOCERA Corporation

次世代モビリティシステム関連製品

自律駆動化を支える高付加価値システムへ事業を拡大



基盤


セラミックパッケージ


EVリレー用
セラミック部品


車載用MLCC

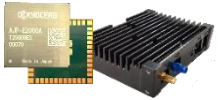

有機基板


コネクタ


LED用
パッケージ

＋ 成長牽引


車載カメラ


ITSモジュール
システム


ミリ波センサ基板


バイフォーカルミラー


光表示デバイス

強みの拡張

顧客との関係性　車載品質・認証　＋　セラミック技術　×　光学技術　×　通信技術　×　電子・電気制御技術

技術の多角的融合による事業創出

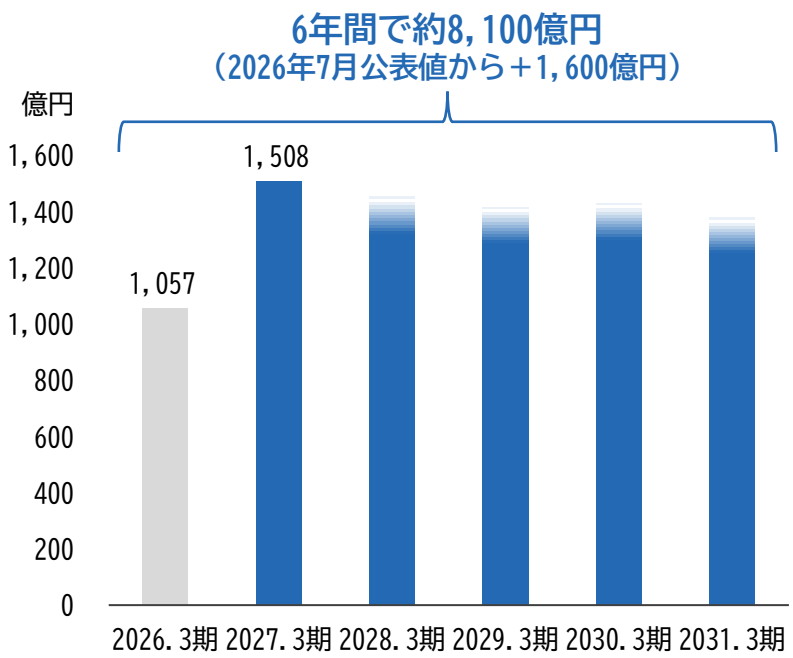
車載部品事業の顧客接点と高品質なモノづくりを活かし、
ADASを軸に高機能・高付加価値化を進め、新用途への応用も視野に入れる

© 2026 KYOCERA Corporation

設備投資・拠点戦略

成長牽引事業を中心に約8,100億円の設備投資を計画

部品事業の設備投資計画（有形固定資産）



生産拠点と主な増産アイテム













増産計画に対し建屋は今上期までに概ね拡張済
2031.3期にかけては内装及び量産設備への投資が中心

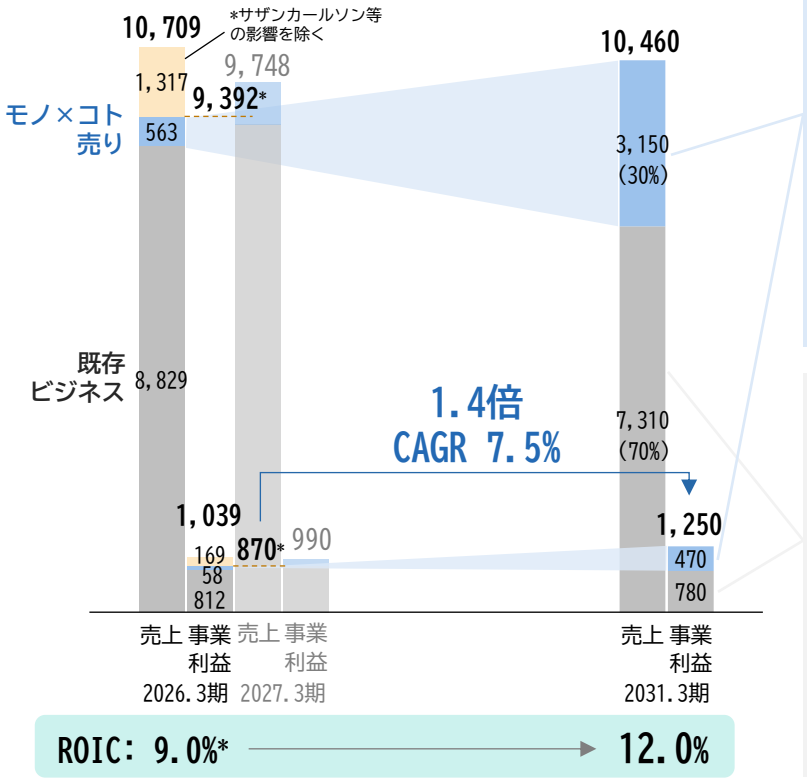
© 2026 KYOCERA Corporation

ソリューション事業

© 2026 KYOCERA Corporation

ソリューション事業　ー　2031.3期 事業計画

売上・事業利益計画（億円）



ROIC：9.0%* → 12.0%

「モノ×コト売り」　2031.3期までに収益の柱へ

顧客接点における新たな価値創造のための体制構築
- 顧客インサイトの深掘りとそれに応じたポートフォリオの最適化
- 高収益な「モノ×コト売り」ソリューションの創出

AI活用プラットフォームの構築及び最大活用
- グローバルでプラットフォームを構築
- 京セラが持つ多様なビジネスから得られる情報の活用（価値の源泉）

グローバル統一の業務プロセス、システム
- 「モノ×コト売り」をグローバルで推進

既存ビジネス

高収益製品の拡大
- 高収益性の新製品開発、販売体制の最適化

原価低減・生産性改善
- 部品内製化やスマートファクトリーの拡大

不採算事業の縮小・撤退
- 「モノ×コト売り」にリソースをシフト

© 2026 KYOCERA Corporation

成長戦略

ソリューションセグメントのグローバル事業基盤を活用し、「モノ」の進化と「モノ×コト売り」の事業創出により収益力を強化

事業基盤

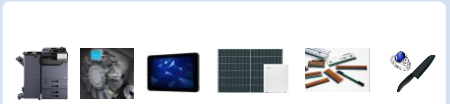
京セラドキュメントソリューションズを中心とした
ソリューションセグメントの
グローバル事業基盤

- グローバルに広がる販売網
- ソリューション販売の経験と実績
- グローバル展開の仕組み



商材の展開

多彩な製品群



×

現場から得る多様なデータ

稼働データ　業務データ　ナレッジデータ

AI活用プラットフォーム

提供するアウトカム

新たな価値創出による
収益力強化

Ver.UP
「モノ」の進化
- 製品の高付加価値化
- 過剰スペックの見直し

×

NEW
「モノ×コト売り」事業の創出



- オフィス
- モノづくり
- プリンティング
- 情報・通信
- 環境

© 2026 KYOCERA Corporation

顧客接点における新たな価値創造

従来

モノづくり

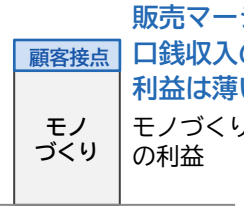
開発・製造における
製品価値向上と原価
低減により利益創出を
最大化

情報の
フィードバック

顧客接点

顧客ニーズに対して
製品・サービスを提供

収益性イメージ



目指す姿

モノづくり

開発・製造における
製品価値向上と原価
低減により利益創出を
最大化

強化

情報の
フィードバック

顧客接点

強化

新たな顧客価値創出

AI活用
プラット
フォーム

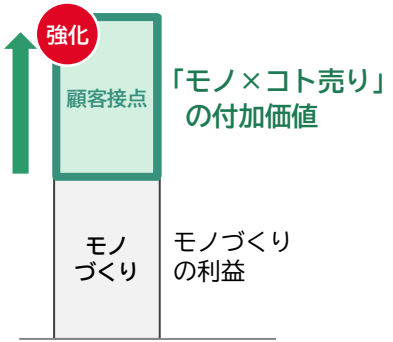
顧客接点で得られる情報をAI活用
プラットフォームで価値に変え、
「モノ×コト売り」によるサービス・
ソリューションを創出

- 高収益なソリューションの創出
- モノづくり部門への情報フィードバック強化

**課題解決の価値を
提供**

- オフィスワーカーの
生産性向上
- 設備の長時間安定稼働/
モノづくりの生産性向上
- 発電効率の向上・
発電出力の最適化
- ⋮

収益性イメージ



**AI活用プラットフォームを基盤に、モノづくりの利益に加え、
「モノ×コト売り」で新たな利益を創出するビジネスモデルへ変革する**

© 2026 KYOCERA Corporation

AI活用プラットフォーム

お客様の現場の製品（モノ）
- MFP
- 蓄電池
- 太陽光パネル
- スマホ・タブレット
- 切削工具

分析に使う社内のデータ
- 業務情報
- 製品情報
- 現場ナレッジ

分析に使う社外のデータ
- 市場データ
- 汎用AI

「モノ×コト売り」AI活用プラットフォーム

1 集める
製品の稼働データと社内外の情報を集める

2 分析する
AIが故障の兆しや使われ方、お客様の困りごとを分析する

3 見つける
AIを使ってお客様向けの価値を見つける

4 届ける
お客様にサービス・ソリューションを届ける

ステップ1～4を続けるほど蓄積される「価値の源泉」

お客様の360度情報
契約・稼働・問い合わせ・請求をお客様ごとに見える化

熟練者のノウハウ
現場で蓄積された知見をAIに蓄え、製品・業務ごとに精度を高める

「モノ」の稼働・品質情報
使われ方や故障・劣化の傾向をため、次の製品の仕様・品質に生かす

「モノ×コト売り」ソリューションの創出

「モノ」の価値高度化・最適化
製品の仕様・品質へフィードバック

© 2026 KYOCERA Corporation

事業目標

既存ビジネス

- MFP/プリンター
- スマホ・タブレット
- セキュリティソフト



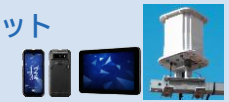
- 切削・電動工具
- 振動センサ
- AGV/AMR



- インクジェット ヘッド/エンジン



- スマホ・タブレット
- 5Gミリ波機器



- 蓄電池
- 制御ソフト



体制構築

顧客接点における新たな価値創造

2028/4 本格稼働

AI活用プラットフォーム

グローバル統一の業務プロセス・システム

5つの「モノ×コト売り」ソリューション



オフィスソリューション
オフィスドキュメントから通信まで最適化を進め、ホワイトカラー生産性向上等の顧客課題を解決



モノづくりソリューション
センシングAIで加工状態を最適化し、長時間の安定稼働と生産性向上を実現



商業用・産業用プリンティングソリューション
印字最適化と遠隔支援、またインクを含めたトータルソリューションで生産性向上を支援



情報・通信ソリューション
通信機器やネットワークデータの分析、遠隔監視、予兆保全等による最適化の推進



環境ソリューション
データ解析に基づいたO&Mサービスによる発電効率向上支援で出力を最適化

売上高（2031.3期）

5,500億円	モノ×コト比率 35%以上
2,100億円	モノ×コト比率 25%以上
820億円	モノ×コト比率 5%以上
1,140億円	モノ×コト比率 25%以上
900億円	モノ×コト比率 35%以上
合計 10,460億円	モノ×コト比率 30%以上

© 2026 KYOCERA Corporation

コーポレート

© 2026 KYOCERA Corporation

事業ポートフォリオマネジメント

2028.3期よりROICを基準とする事業ユニット単位の評価を開始

事業評価単位・主たる目的

2027.3期
- プロダクトライン(事業本部)単位 14ユニット
- 収益性や投資効率を重視した事業計画の立案・進捗管理

2028.3期～
- 市場別/製品別に分類した事業ユニット単位 48ユニット
- リソース配分の最適化を目的とした事業ポートフォリオマネジメント

機動性・流動性を高めるためより細かな単位で管理

運用フロー（毎年度実施）

Step1：収益性による定量評価
ROIC　営業利益

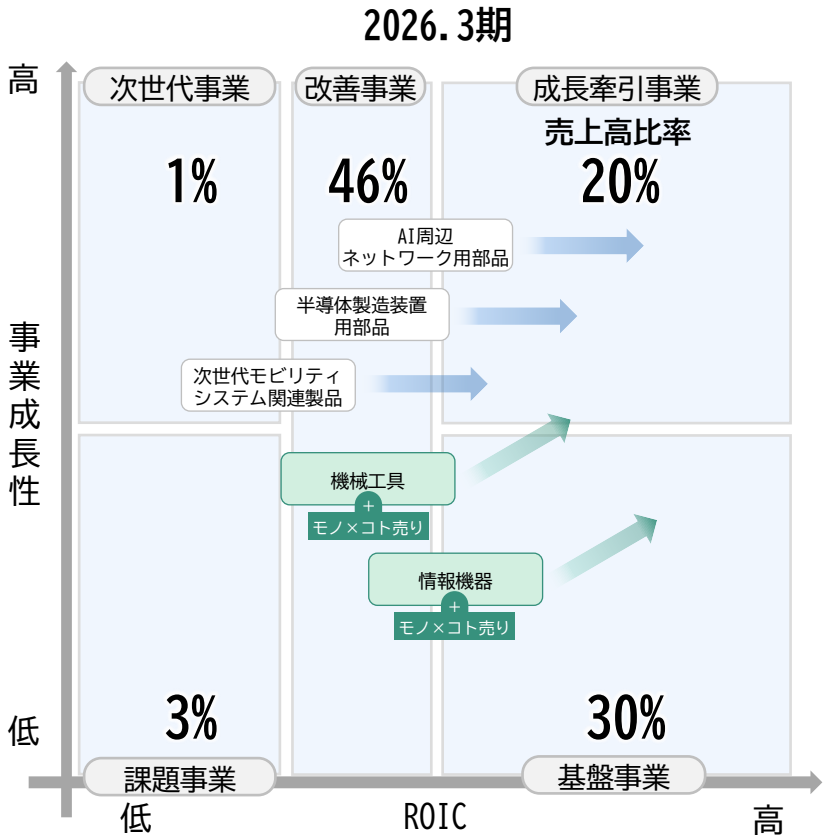
Step2：事業性や改善可能性による評価
事業成長性　競争優位性
想定リスク　全社への利益貢献度

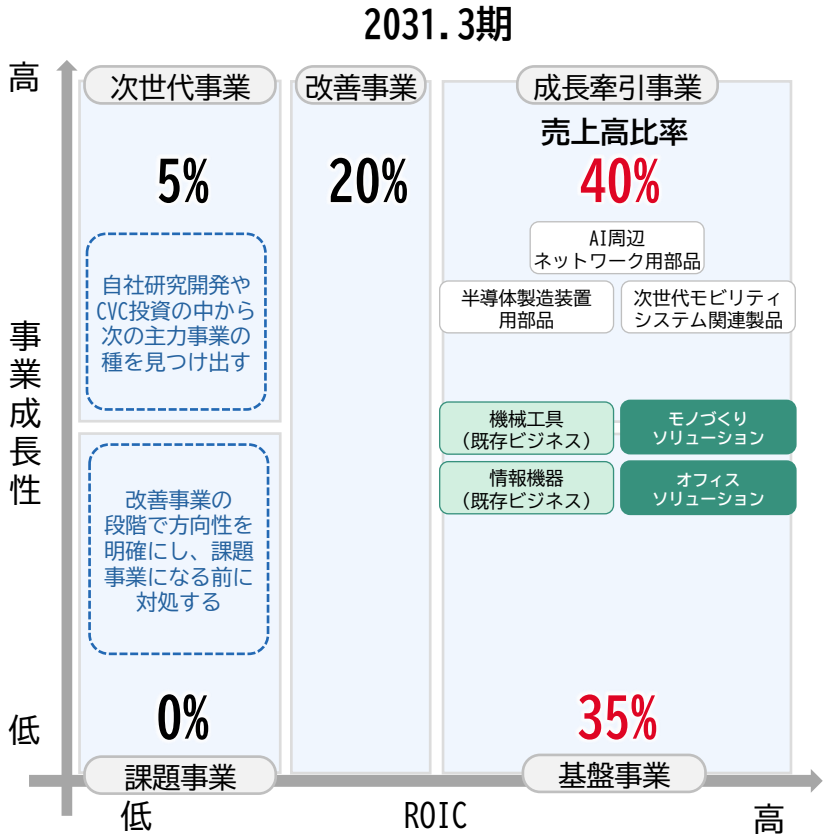
Step3：全社視点での総合評価
モニタリングボードで議論し方向性を明確にする

© 2026 KYOCERA Corporation

2031.3期に向けた事業ポートフォリオ改革

※一部の事業ポートフォリオを記載

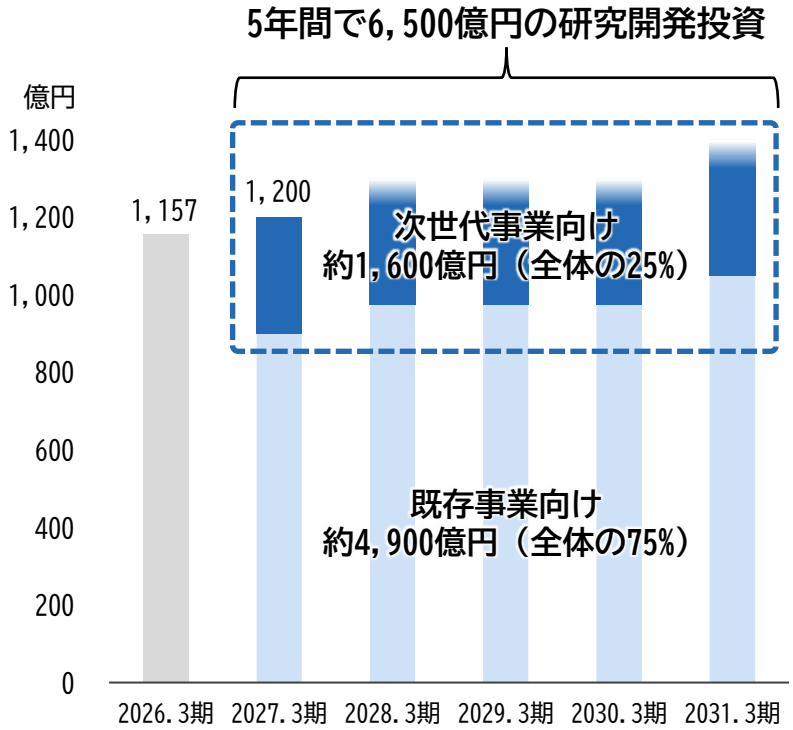




© 2026 KYOCERA Corporation

研究開発投資計画

セラミック技術の深化により次世代事業創出を加速する



自社独自開発

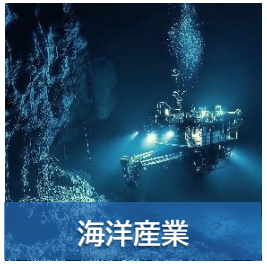
CVCの活用

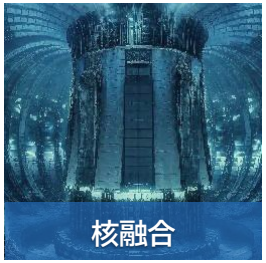
セラミックスの
技術特性

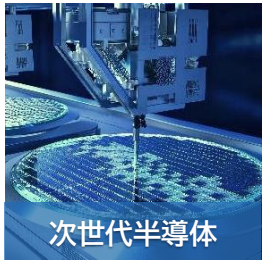
- 耐熱性/耐熱衝撃性
- 耐プラズマ性
- 高剛性
- 耐放射線性　etc.

セラミック技術を深化させ AIに続く成長市場へ









© 2026 KYOCERA Corporation

資本政策の推進

競争力強化と将来キャッシュフロー拡大を目指した資本配分

キャピタル・アロケーション
2027.3期～2031.3期 5ヵ年計画

M&Aに対する負債活用

※M&A等のインオーガニック投資に対して更なる負債活用も検討

営業キャッシュフロー
約2兆1,000億円
（研究開発費控除前）

保有株式売却収入
約7,000億円

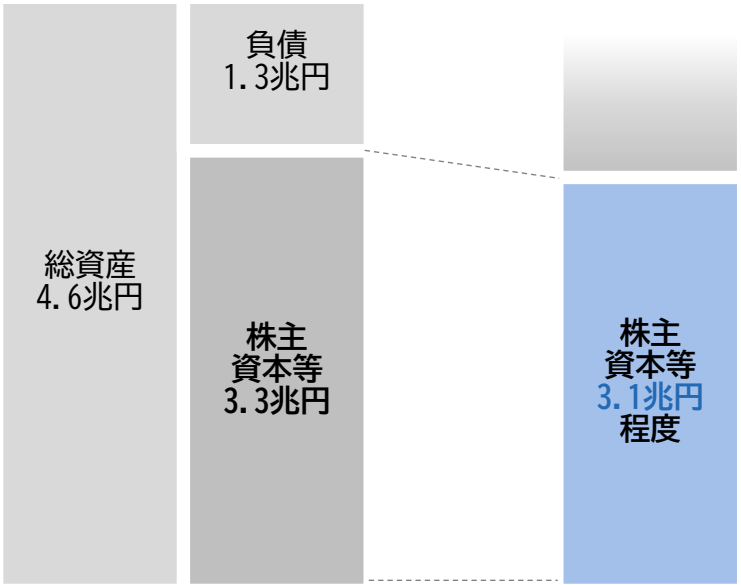
設備投資
約9,000億円

研究開発費
約6,500億円

配当金　約4,000億円

M&A/自己株式取得
約8,500億円

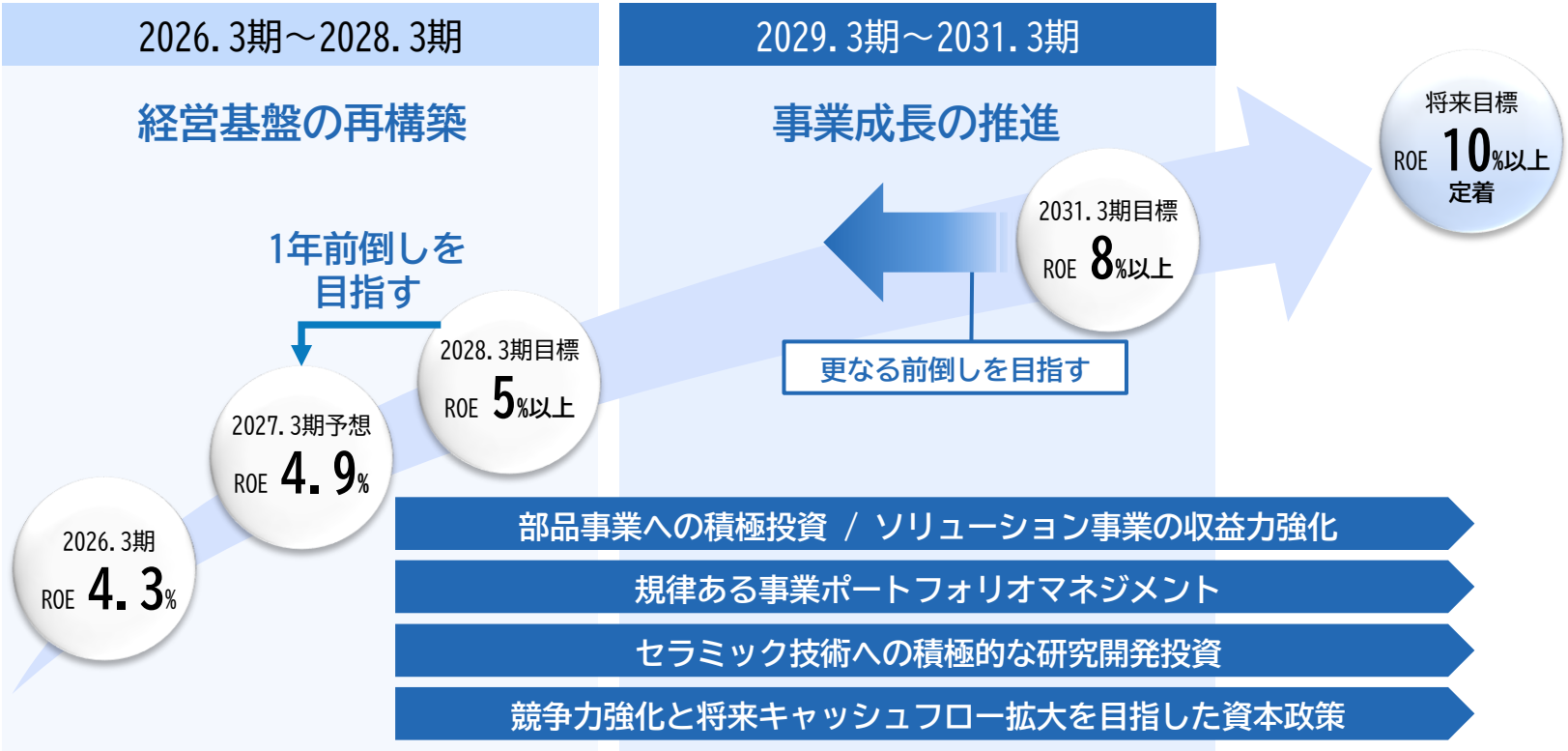
資本構成



© 2026 KYOCERA Corporation

最後に

事業戦略・資本政策を着実に実行し、早期のROE 8%達成と持続的な成長を目指す



© 2026 KYOCERA Corporation

将来の見通しに関する記述等について

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

(1) 日本及び世界経済の一般的な状況
(2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
(3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
(4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
(5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
(6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
(7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
(8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
(9) 優れた人材の確保が困難となる事態
(10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
(11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
(12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
(13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
(14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
(15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
(16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
(17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
(18) 売掛債権の信用リスク
(19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
(20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
(21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
(22) 会計基準の変更

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の業績、事業活動、 展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。

© 2026 KYOCERA Corporation



京セラ株式会社

© 2026 KYOCERA Corporation